

Bondmaster ESP110 Epoxy Mono Composant



ZI Nord BP438
69655 Villefranche sur Saone
France
Tel: 04 74 02 39 42
Fax: 04 74 02 39 43

Fiche Technique

Description:

Bondmaster ESP110 est une résine époxy mono-composant thixotrope. Cette colle a été développée pour réaliser des assemblages qui seront soumis à des impacts, du clivage, du pelage, de la traction cisaillement ou des contraintes thermiques ou chimiques. Vous pourrez le substituer à l'utilisation de rivets, de soudure ce qui vous fera économiser du temps et vous donnera une meilleure esthétique.

Propriétés Physiques

Couleur	argent
Viscosité (mPa.s)	400.000
Densité	1,50

Performances

Traction cisaillement (N/mm ²) - Acier*	30
Coeff. Expansion Thermique (mm/mm/°C)	45 x 10 ⁻⁶
Jeu maximum (mm)	4

Lors d'assemblages de matériaux tels que des ferrites ou du SMC la résistance de l'adhésif sera supérieure à celle du substrat. La résistance mesurée sur des métaux tels que le cuivre ou ces alliages pourra être affectée par le module d'élasticité ou l'épaisseur des pièces.

Stockage :

La durée de vie de ce produit est de 9 mois à partir de la date d'envoi de notre usine. La durée de vie n'est valable que dans la mesure où le produit a été stocké à une température de 5-7°C dans son emballage d'origine non ouvert.

Température de Service:

La température de service recommandée pour le ESP110 est comprise entre -40 et +180°C. Par ailleurs il peut être soumis à des températures plus élevées dans la mesure où il n'est pas sous contrainte.

Principes de sécurité et d'hygiène:

Nous pouvons vous fournir la Fiche H & S sur simple demande. Les utilisateurs pourront ainsi utiliser nos produits dans les meilleures règles d'hygiène.

Vitesse de polymérisation

	100°C	120°C	150°C	180°C
Minutes* (étuve à circulation d'air)	240	60	45	20

* Le temps de polymérisation est dépendant du temps nécessaire que mettra le joint de colle à atteindre sa température. Des pièces importantes demanderont un temps supérieur pour cause d'inertie thermique. L'utilisation d'autres méthodes telles que des plaques chauffantes, des infrarouges ou de l'induction diminuera de façon significative le temps de polymérisation.

Notice d'utilisation:

Les surfaces doivent être propres, sèches et parfaitement dégraissées avant la dépose de notre adhésif. Lorsque la résistance maximum est demandée, les surfaces seront soit sablées ou abrasées en complément de notre préparateur de surface Bondmaster SIP.

La colle devra être déposée en cordon et il sera important de ne pas enfermer d'air. Elle sera appliquée uniquement sur une des surfaces.

Assembler les deux pièces avec suffisamment de pression pour que la colle couvre toute la surface. Maintenir une pression par un clampage et ne pas modifier l'assemblage pendant toute la phase de polymérisation.

Bondmaster ESP110 est thixo, il ne coulera donc pas pendant sa phase de polymérisation.

Les détails et les recommandations que nous fournissons ici sont basés sur notre expérience technique et nous les tenons pour exacts. Cependant, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à leur exactitude et nous n'acceptons aucune responsabilité par rapport à ces indications. de plus, aucune déclaration faite ici ne doit être considérée comme étant une représentation ou une garantie. Avant d'employer ces produits, les acheteurs doivent toujours effectuer leurs propres essais afin d'établir si le produit en question convient ou non à leurs fins spécifiques sous leurs propres 28/07/04